

2023年5月24日
株式会社ダイセル

電子機器 2023 トータルソリューション展に出展

株式会社ダイセル（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小河義美）は、エレクトロニクス実装に特化した総合展示会「電子機器 2023 トータルソリューション展」内の JPCA Show 2023 に出展します。

本展示会は、電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路の材料、装置、部品等が一堂に集まる「エレクトロニクス実装に関する代表的な総合展」です。

当社展示ブースでは次の 5 つのテーマに沿って、当社、ポリプラスチックス株式会社およびダイセル・オルネクス株式会社のグループ 3 社のユニークで最先端の商材、技術をご紹介します。

【出展テーマ】

- ① 高周波プリント配線板向け超低誘電損失樹脂
- ② 3D パッケージ対応材料
- ③ LAPEROS® LCP 誘電率制御グレード
- ④ 熱硬化から UV/EB 硬化システムへの切り替えソリューション
- ⑤ SiN 選択的吸着材 ナノひつつき虫™

当社は 5G/6G に向けた高周波対応低損失樹脂、異種デバイスのインテグレーションに対応する 3D パッケージ対応材料、エッチング液からシリコン窒化膜の選択保護剤を、エンジニアリングプラスチックのリーディングカンパニーであるポリプラスチックスは高周波通信コネクタ向け LCP を、ダイセル・オルネクスは光・エネルギーを用いた UV 硬化型樹脂、難接着材料へ対応した良接着樹脂を紹介します。



<出展概要>

【展示会名】 電子機器 2023 トータルソリューション展

【会場】 東京ビッグサイト 東展示棟
出展展示会： JPCA Show 2023
出展ゾーン： プリント配線板技術展
小間番号： 5G-03

【会期】 2023年5月31日（水）～2023年6月2日（金）
開催時間 10:00～17:00

【出展内容】

- ・次世代超低誘電損失樹脂
- ・低誘電&低硬化収縮 脂環式エポキシ樹脂
- ・銅-銅低温接合材料
- ・ポリマーハイブリッドボンディング材料
- ・有機-無機ハイブリッド耐熱接着剤
- ・SMT対応 高周波通信コネクタ用材料 LAPEROS® LCP 誘電特性制御グレード
- ・高周波通信に対応する電磁波シールド用材料 LAPEROS® LCP 高導電材料
- ・熱硬化からUV硬化への切り替えソリューション
- ・各種基材への密着対応
- ・シリコン窒化膜 選択保護剤 Nanotrex®

出展内容に関する詳細は、主催者サイト内の紹介ページをご覧ください。

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/jpca2023/jp/jpca/details/IM5Xz3TR5_4

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ダイセル

スマート SBU 事業推進室 戦略企画グループ

担当:八甫谷(はっぽうや)

TEL:03-6711-8255